

JDB811 单组份热固化导热粘接剂 (T200)

产品描述

JDB811T200单组份加热固化粘接剂是一种加成型高强度粘接性导热有机硅材料。可应用于各种电子电器元件的粘接密封，如家电、汽车、通讯等行业各电子器件。

产品特性

- 单组份，使用前无需混合，操作方便；
- 加成型硅胶，固化时无低份子脱出，固化后产品尺寸更稳定；
- 优异的导热绝缘性能，有助于发热性电子元器件的散热和保护；
- 在-60-250℃间稳定的机械和电气性能；
- 阻燃性能优异，完全符合欧盟环保指令要求。

产品用途

产品适用于多种电子，电器以及需要粘接，密封，导热，绝缘，保护，防潮，防尘等应用场合，如冰箱电器件中，取代铝箔应用于冷凝管与侧板、蒸发管与箱胆粘贴等。

主要性能

项目	典型值	测试标准
固化前性能 (23±2℃/50±5%RH)		
外观	--	灰色膏状物
比重	g/cm ³	2.7±0.1
固化后性能 (23±2℃/50±5%RH×7days)		
固化条件 (150℃)	Min	20
邵氏硬度	Shour A	85±10
延伸率	%	≥20
拉伸强度	MPa	≥4.5
导热率	W/(m.K)	2.0±0.2
剪切强度 (AL/AL)	MPa	≥4.4
介电强度	kV/mm	22
介电常数 (1MHz)	--	4.9
体积电阻率	Ω·cm	≥2.0×10 ¹³

工作温度	°C	-50~200	--

使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净、干燥，并去除锈迹、灰尘和油污等任何可能影响附着力的污染物。
- 将胶液用专用工具挤出，涂布于已清理干净之接着面。
- 施胶完成后移入烘箱或者加热环境进行固化，根据实际情况可以适当延长固化时间和提高固化温度效果更好。

注意事项

- 胶料应密封（ $0\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）冷藏贮存，长期存放于常温或者高温环境下会缩短储存期。
- 本品属非危险品，但避免接触皮肤及眼睛。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会导致胶不固化或者固化不完全：
 - 1 含N、P和S等的有机化合物。
 - 2 含Sn、Pb、Hg和As 等元素的离子性化合物。
 - 3 含炔烃及多乙烯基的化合物。
- 为了避免上述现象，胶液灌封、点胶使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。
- 本产品在使用后，应将胶管密封，可保存再次使用。本产品仅供工业用途。

包装规格

- 300ml/支瓶装，每箱 24 支装。
- 50ml/支管装。

储存及运输

- 远离儿童存放。
- 本产品于（ $0\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）环境中贮存期为六个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

我们能为您提供哪些帮助？

请告知我们您的性能、设计和制造问题。我们将利用我们的硅基物料专知，敷涂知识和加工经验为您提供服务。